

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-001

深圳市科思科技股份有限公司

关于公司新一代芯片研发进展的

自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）研发的新一代智能无线电基带处理芯片已完成试产流片工作，芯片已回片点亮，该研发项目取得阶段性成果。后续高芯思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试。

一、 芯片研发情况

公司新一代智能无线电基带处理芯片已回片点亮，后续高芯思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试。该款芯片主要用于智能无线电通信产品中，采用软件无线电、认知无线电等相关先进技术，完成无线通信数字信号处理及协议栈处理等主要功能。芯片主要关键指标均比公司上一代产品大幅提升，可支持更多的自有通信波形及用户定制波形；支持更先进的编译码方式；支持更丰富的加解密算法；支持更大的组网能力，组网规模相比公司上一代产品成倍增长。

二、 对公司的影响

公司成功完成新一代智能无线电基带处理芯片的试产流片工作，验证了公司技术路线的可行性，有利于继续推进芯片研发的下一阶段工作，为后续芯片量产奠定了基础。该款芯片将进一步丰富公司产品线和核心技术储备，增强公司无线通信产品的核心竞争力，形成公司的优势护城河，同时有利于提升公司所在领

域的产品市场占有率。未来公司将持续深耕研发，不断增强研发实力，提升产品竞争力。

该产品尚未完成测试工作，未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测。

三、 风险提示

公司新一代智能无线电基带处理芯片的功能、性能测试极为复杂，目前尚未完成全部测试工作，同时，该款芯片未来的市场需求、市场拓展及竞争情况尚具有不确定性。

关于该款芯片后续进展情况，公司将持续跟进，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年1月10日